硅片抛光片与外延片区别是什么？

根据用途分类，半导体硅片可分为抛光片、退火片、外延片、结隔离片和以SOI硅片为代表的高端硅片。

抛光片可以用于制作存储芯片，功率器件，以及外延片的衬底材料。外延片，是在抛光片的基础上生长了一层单晶硅，一般用于通用处理器芯片，二极管，以及igbt功率器件的制造。由于抛光原始颗粒细微、粒度尺寸小于可见光的波长，所以均匀地分布后形成外观透明或半透明的抛光膜。

原文地址：http://www.china-nengyuan.com/baike/7531.html